

新十八号文给力软件和集成电路行业

李项峰 SAC 执业证书编号:S0120109030554
Lixf@tebon.com.cn 8621-68761616-8316
李明选 Limx@tebon.com.cn 8621-68761616-8518

事件:

国务院常务会议研究部署进一步鼓励软件和集成电路行业发展

政策要点:

国务院常务会议在强化投融资支持,加大对研究开发的支持力度,实施税收优惠,加强人才培养和引进,完善对研发人员的激励机制,落实软件和集成电路知识产权保护制度,依法打击各类侵权行为,强化市场引导,规范市场秩序等方面对软件和集成电路行业进行产业支持;

会议决定延续2000年18号文的相关决议,对两行业继续执行增值税减免政策;

进一步落实和完善相关营业税优惠政策,对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税;

对集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业,自获利年度起,实行企业所得税“两免三减半”优惠政策;

对集成电路线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元的集成电路生产企业,自获利年度起,实行企业所得税“五免五减半”优惠政策;

努力实现关键技术整体突破,加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用。紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标,重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订;

严格落实软件和集成电路知识产权保护制度,依法打击各类侵权行为。加大对网络环境下软件著作权、集成电路布图设计专有权的保护力度;

进一步推进软件正版化工作，探索建立长效机制。凡在我国境内销售的计算机（大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件必须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。

市场影响：

新十八号文对市场的影响将是长期和深远的，预计在今年两会期间将会进一步强调对软件和集成电路行业的产业支持政策。该政策对二级市场的影响主要是两类公司：软件类公司和从事集成电路及芯片设计、封装、测试的公司。前者关注软件服务和应用开发占比较高的公司，例如中国软件（600536）和东软集团（600718）。集成电路和半导体设计、封装测试领域关注综艺股份（600770）和士兰微（600460）

投资评级

一、行业评级

推荐 – Attractive:	预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数
中性 – In-Line:	预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平
回避 – Cautious:	预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数

二、股票评级

买入 – Buy:	预期未来 6 个月股价涨幅 $\geq 20\%$
增持 – Outperform:	预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20%
中性 – Neutral:	预期未来 6 个月股价涨幅为-10% - +10%
减持 – Sell:	预期未来 6 个月股价跌幅 $> 10\%$

特别声明

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对报告中信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归德邦证券有限责任公司所有。未获得德邦证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“德邦证券有限责任公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。